

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0522)

截至二零二五年九月三十日止三個月之
二零二五年第三季度未經審核業績公布

人工智能推動強勁勢頭

關鍵亮點

- * 先進封裝及主流業務均受惠於人工智能
- * TCB 技術於第四代高頻寬記憶體及先進邏輯領域保持領導地位
- * 來自記憶體及邏輯客戶的 TCB 重複訂單
- * SMT 復蘇，新增訂單總額勝預期
- * 經調整，本季度盈利（不包括策略性重組成本）

集團財務概要: 二零二五年第三季度

(港幣百萬元)	二零二五年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	3,620.7 (4.63 億美元)	-3.5%	+14.2%
銷售收入	3,661.2 (4.68 億美元)	+7.6%	+9.5%
毛利率	35.7%	-405 點子	-532 點子
經營利潤	50.5	-70.2%	-71.7%
盈利/（虧損）	(268.6)	NM	NM
每股基本盈利	港幣(0.65)元	NM	NM
非香港財務報告會計準則計量 ¹			
經調整毛利率	37.7%	-203 點子	-330 點子
經調整經營利潤	124.4	-26.6%	-30.3%
經調整盈利	101.9	-24.4%	+245.2%
經調整每股基本盈利	港幣 0.24 元	-25.0%	+200.0%

NM: 無意義

二零二五年第四季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季+6.8%，按年亦+14.3%

¹ 有關上述非香港財務報告會計準則計量之詳情，請參閱本業績公告之「香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節。

ASMPT Limited 董事會欣然宣布截至二零二五年九月三十日止三個月之未經審核業績如下：

業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司(「集團」或「ASMPT」)於截至二零二五年九月三十日止三個月(「二零二五年第三季度」)錄得銷售收入為港幣 36.6 億元(4.68 億美元)，分別按季增加 7.6%及按年增加 9.5%。集團二零二五年第三季度的綜合除稅後虧損為港幣 2.69 億元。然而，根據非香港財務報告會計準則計量¹經調整除稅後盈利為港幣 1.02 億元，按季減少 24.4%，按年則增加 245.2%。

二零二五年第三季度的每股基本(虧損)盈利為港幣(0.65)元，而根據非香港財務報告會計準則計量¹經調整每股基本盈利為港幣 0.24 元。按此非香港財務報告會計準則計量¹，按季減少 25.0%，按年則增加 200.0%。

管理層討論及分析

二零二五年第三季度的回顧將由業務亮點開始解說，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部(「SEMI」)及表面貼裝技術解決方案分部(「SMT」)的財務回顧。

二零二五年第三季度集團業務摘要

集團的先進封裝(「AP」)及主流業務繼續受惠於人工智能的持續採用。在先進封裝業務方面，其熱壓焊接(「TCB」)解決方案在先進記憶體及邏輯應用領域均成功獲得客戶的重複訂單。人工智能基礎設施，包括數據中心、數據傳輸及能源管理，推動了對主流業務的需求。在中國市場，電動汽車(「EV」)及外判半導體裝嵌及測試企業的高廠房利用率亦帶動需求。然而，中國以外的汽車及工業市場的貢獻仍然疲弱。

先進封裝：人工智能推動需求

集團在先進封裝市場的強勢地位，主要由於其 TCB 在先進邏輯領域持續佔據領導地位，過去一年迅速進軍高頻寬記憶體(「HBM」)市場，以及在第四代高頻寬記憶體方面具有先發優勢。以下是集團先進封裝解決方案的若干亮點：

TCB:記憶體及邏輯解決方案重複訂單

在記憶體方面，集團的 TCB 解決方案實現優於競爭對手的良率。於二零二五年第三季度，集團針對 12 層第四代高頻寬記憶體所推出的 TCB 解決方案率先接獲多家高頻寬記憶體企業的訂單，並預計將繼續成為一間主要供應商，展現其在迅速轉型至第四代高頻寬記憶體方面的技術領導地位。此外，其免助焊劑主動去除氧化(「AOR」)的專有技術，具備卓越的可擴展性，可為 16 層及以上高頻寬記憶體應用，同時實現最低轉型成本。

在邏輯方面，集團繼續贏得主要客戶在晶片到基底(「C2S」)應用工藝標準(「POR」)的訂單。隨著市場轉向採用更大的複合固晶，集團已準備就緒，將於二零二五年第四季度及之後從領先晶圓代工的外判半導體裝嵌及測試合作夥伴獲得大額訂單。集團的晶片到晶圓(「C2W」)超微間距 TCB 等離子主動去除氧化解決方案已成功通過領先晶圓代工客戶的最終質量及可靠性認證，並已準備大批量生產。相關等離子技術已得到上述領先晶圓代工客戶的認可，突顯了其較其他工藝的技術優勢。

管理層討論及分析(續)

混合式焊接（「HB」）：第二代工具已交付

集團於二零二五年第三季度繼續交付混合式焊接工具。第二代混合式焊接解決方案在精確對正、焊接準確度、生產布局效率、每小時產能(「UPH」)方面具競爭優勢。集團亦積極與主要邏輯及記憶體企業合作，各個項目正處於不同的評估階段。

光子和共同封裝光學（「CPO」）：勢頭延續

集團繼續主導光學收發器市場，鞏固其作為 800G 收發器主要供應商的領導地位，同時積極與行內企業合作開發新一代 1.6T 光子解決方案。集團的共同封裝光學解決方案具使其傲視同儕的技術優勢，並已與主要共同封裝光學企業緊密合作。

表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝解決方案：二零二五年第三季度的新增訂單總額強勁增長

表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝解決方案贏得來自整合設備製造商客戶及外判半導體裝嵌及測試企業的大量系統封裝(「SiP」)訂單，提供基站射頻模組以支持人工智能的發展。此外，表面貼裝技術解決方案分部亦繼續取得來自一間領先晶圓代工和多間外判半導體裝嵌及測試企業用於先進邏輯智能手機應用的新一代晶片裝嵌工具更多訂單。

主流業務：人工智能及中國市場推動需求

人工智能的需求繼續惠及集團的主流業務，主要受數據中心對增強能源管理能力及基站對人工智能伺服器主機板的需求提升所驅動。

在中國市場，主流業務在半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部方面的需求持續增長。半導體解決方案分部的焊線機及固晶機應用的新增訂單總額，受惠於外判半導體裝嵌及測試廠房利用率持續提高所驅動。表面貼裝技術解決方案分部的需求主要來自電動汽車，其在中國仍保持領先地位。

AEC 自願清盤：按計劃進行

如二零二五年八月十一日的公布所示，集團啟動對其中一間位於中國的製造工廠，先進半導體設備(深圳)有限公司(「AEC」)進行自願性清盤。清盤工作正在按計劃進行。本集團於二零二五年第三季度就重組(遣散費及停產相關成本)及存貨註銷入賬港幣 3.55 億元(人民幣 3.20 億元)。上述費用不包括在非香港財務報告會計準則計量當中。預期未來年度節省成本約港幣 1.28 億元(人民幣 1.15 億元)，這將直接提升集團營運的成本效益。

管理層討論及分析(續)

集團二零二五年第三季度財務回顧

(港幣百萬元)	二零二五年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	3,620.7 (4.63 億美元)	-3.5%	+14.2%
銷售收入	3,661.2 (4.68 億美元)	+7.6%	+9.5%
經調整毛利率 ¹	37.7%	-203 點子	-330 點子
經調整經營利潤 ¹	124.4	-26.6%	-30.3%
經調整盈利 ¹	101.9	-24.4%	+245.2%
經調整盈利率 ¹	2.8%	-118 點子	+190 點子

於二零二五年第三季度，銷售收入為港幣 36.6 億元（4.68 億美元），按季增長 7.6%，按年亦增長 9.5%，主要受表面貼裝技術解決方案分部的增長所推動，略低於銷售收入預測的中位數。

受人工智能勢頭所推動，於二零二五年第三季度集團的新增訂單總額為 4.63 億美元，連續第六個季度實現按年增長。一間領先的高密度基板製造商由於消化現有產能的速度慢於其預期，於二零二五年第三季度取消了其面板沉積設備的個別訂單。若不包括此項取消，集團於二零二五年第三季度的新增訂單總額將為 4.87 億美元，按季增長 1.5%，按年亦增長 20.1%。集團於季內錄得訂單對付運比率為 1.04，自二零二五年第一季度以來維持在 1 以上的比率。表面貼裝技術解決方案分部的比率高達 1.12，而半導體解決方案分部的比率則為 0.96。

集團於本季度末的未完成訂單總額約為 8.68 億美元。

集團經調整毛利率為 37.7%，按季下降 203 點子，按年亦下降 330 點子。經調整毛利率受到來自表面貼裝技術解決方案分部重大貢獻，及半導體解決方案分部的產品組合和相對較低的製造利用率所影響。年初至今的經調整毛利率保持在約 40%。

集團營運支出為港幣 12.6 億元，按季增長 6.2%，按年亦增長 5.3%。亦如預期，營運支出增加主要是由於策略性研發、資訊技術基礎設施投資及外幣匯兌影響所致，部分被審慎的支出管控及重組效益所抵銷。

集團經調整經營利潤為港幣 1.24 億元，按季下降 26.6%，按年亦下降 30.3%，主要受毛利率下降和營運開支上升所致。

集團經調整盈利為港幣 1.02 億元，按季下降 24.4%，按年則增長 245.2%。按季經調整盈利包括上述取消訂單而收取的費用，及無上季度稅項抵免入賬所抵銷。經調整盈利按年增長，由於上述取消訂單而收取的費用及外幣匯兌的負面影響減輕所致。

管理層討論及分析(續)

二零二五年第三季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二五年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,626.8 (2.08 億美元)	-1.7%	-12.4%
銷售收入	1,879.8 (2.40 億美元)	-6.5%	+5.0%
經調整毛利率*	41.3%	-341 點子	-728 點子
經調整分部盈利*	82.6	-52.8%	-41.5%
經調整分部盈利率*	4.4%	-431 點子	-349 點子

* 不包括主要因 AEC 自願性清盤而優化產品組合所產生的一次性存貨註銷為港幣 7,390 萬元。

半導體解決方案分部於二零二五年第三季度的銷售收入為港幣 18.8 億元（2.40 億美元），按季下降 6.5%，按年則增長 5.0%。銷售收入按年增長是由於跨應用的能源管理需求上升，使對焊線機及固晶機的需求增加所致。銷售收入按季下滑是由於主要客戶的人工智能技術發展藍圖時間安排，影響本季對先進封裝的需求，加上中國近期的颱風影響也導致部分交付受到干擾。

半導體解決方案分部於二零二五年第三季度的新增訂單總額為港幣 16.3 億元（2.08 億美元），按季下降 1.7%，按年亦下降 12.4%。若撇除上文所述取消的訂單，半導體解決方案分部於二零二五年第三季度的新增訂單總額將達 2.32 億美元，按季增長 9.6%，按年則輕微下降。半導體解決方案分部的焊線機及固晶機錄得按季及按年增長，TCB 訂單亦錄得按季增長，但如上文所述，由於先進封裝的需求的影響，TCB 的訂單維持較低水平。

半導體解決方案分部於二零二五年第三季度的經調整毛利率為 41.3%，按季下降 341 點子，按年亦下降 728 點子。毛利率按季下滑主要受二零二五年第三季度焊線機佔比上升、TCB 銷售收入減少及製造利用率偏低所致。按年下降則是受二零二四年第三季度 TCB 高製造產能所造成的高基數影響，以及於本季度焊線機的佔比上升所致。半導體解決方案分部於年初至今的經調整毛利率維持在 40%的中間水平，先進封裝的毛利率亦保持穩定。

於二零二五年第三季度的經調整分部盈利為港幣 8,260 萬元，按季下降 52.8%，按年亦下降 41.5%，主要由於毛利率下降和營運開支上升所致。

二零二五年第三季度 SMT 解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二五年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,993.9 (2.55 億美元)	-5.0%	+51.8%
銷售收入	1,781.4 (2.28 億美元)	+28.0%	+14.6%
毛利率	33.9%	+136 點子	+163 點子
分部盈利	163.0	+205.0%	+65.6%
分部盈利率	9.1%	+531 點子	+282 點子

表面貼裝技術解決方案分部錄得強勁銷售收入達港幣 17.8 億元（2.28 億美元），按季增長 28.0%，按年亦增長 14.6%。增長主要受亞洲市場的強勁表現所帶動，這受惠於人工智能伺服器、中國電動汽車以及於二零二五年第二季度智能手機批量訂單的交付。然而，來自中國以外的汽車及工業市場的貢獻仍然疲弱。

管理層討論及分析(續)

表面貼裝技術解決方案分部於二零二五年第三季度的新增訂單總額為港幣 19.9 億元（2.55 億美元），按季下降 5.0%，按年則增長 51.8%。新增訂單總額按季略微下降是由於第二季度智能手機批量訂單的高基數影響，而按年增長則是受到先進封裝及中國主流市場的強勁勢頭所推動。先進封裝的新增訂單總額受惠於電信基站和人工智能伺服器的整合設備製造商及外判半導體裝嵌及測試企業的需求，而中國主流業務亦因電動汽車的需求而錄得強勁按年增長。

分部毛利率為 33.9%，按季上升 136 點子，按年亦上升 163 點子，及分部盈利為港幣 1.63 億元，按季增長 205%，按年亦增長 65.6%。兩者均因受銷售量增加效應所推動。

前景

集團預期二零二五年第四季度的銷售收入將介乎於 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季增長 6.8%，按年亦增長 14.3%，高於市場預期。此增長將同時由半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的勢頭所驅動。

展望未來，受益於近期有關人工智能生態系統投資的消息，集團預計其 TCB 總潛在市場將於二零二七年可突破 10 億美元。人工智能數據中心將持續推動對先進封裝的需求，尤其是用於第四代高頻寬記憶體及先進邏輯的 TCB，集團正是該領域的技術領導者。

集團的主流業務將受惠於全球對人工智能基礎設施的投資，以及來自中國的穩定需求。然而，汽車及工業終端市場的復蘇前景仍不明朗。

儘管集團尚未受到關稅政策的任何重大影響，但認同存在不確定性。憑藉其全球布局，集團能夠靈活應對任何潛在影響，其將繼續密切關注局勢，並根據需要進行調整。

財務概要

簡明綜合損益表

		截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
<i>附註</i>				
銷售收入	2	3,661,200	3,401,714	3,344,731
銷貨成本	3	(2,355,450)	(2,050,878)	(1,974,030)
毛利		1,305,750	1,350,836	1,370,701
其他收入		91,304	38,593	46,181
銷售及分銷費用		(411,187)	(390,862)	(371,221)
一般及行政費用		(308,663)	(264,726)	(287,736)
研究及發展支出		(535,420)	(525,888)	(533,426)
其他收益及虧損, 淨值		(15,802)	(55,732)	(118,041)
重組費用		(304,316)	(755)	(7,455)
其他支出		(27,938)	(14,418)	(9,231)
財務費用		(36,482)	(39,948)	(53,272)
合營公司業績持份		20,729	9,468	(1,224)
除稅前(虧損)盈利		(222,025)	106,568	35,276
所得稅(開支)抵免		(46,574)	27,770	(11,431)
本期間(虧損)盈利		(268,599)	134,338	23,845
以下各方本期間應佔(虧損) 盈利:				
本公司持有人		(269,877)	131,214	25,908
非控股權益		1,278	3,124	(2,063)
本期間(虧損) 盈利		(268,599)	134,338	23,845
每股(虧損)盈利				
4				
– 基本		港幣(0.65)元	港幣 0.32 元	港幣 0.06 元
– 攤薄		港幣(0.65)元	港幣 0.31 元	港幣 0.06 元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間(虧損) 盈利	(268,599)	134,338	23,845
其他全面收益(支出)			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
– 其他全面收益以公平價值列賬的權益性 工具投資之公平價值收益淨額	11	495	575
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
– 換算海外營運公司匯兌差額			
– 附屬公司	(99,035)	735,215	441,305
– 合營公司	(6,021)	10,942	3,164
– 被指定對沖現金流的對沖工具之 公平價值收益(減值)	10,322	(17,527)	(14,352)
本期間其他全面(支出)收益	(94,723)	729,125	430,692
本期間全面(支出)收益總額	(363,322)	863,463	454,537
以下各方本期間應佔全面(支出)收益總額:			
本公司持有人	(364,471)	859,090	455,338
非控股權益	1,149	4,373	(801)
	(363,322)	863,463	454,537

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團有兩個（二零二四年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二四年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	1,879,838	2,010,164	1,790,053
表面貼裝技術解決方案	1,781,362	1,391,550	1,554,678
	3,661,200	3,401,714	3,344,731
分部盈利			
半導體解決方案	8,735	174,887	141,141
表面貼裝技術解決方案	162,983	53,444	98,446
	171,718	228,331	239,587
利息收入	22,329	24,893	33,104
財務費用	(36,482)	(39,948)	(53,272)
合營公司業績持份	20,729	9,468	(1,224)
未分配其他收入	6,908	6,418	4,827
未分配外幣淨匯兌減值及外幣 遠期合約的公平價值變動	(17,741)	(51,848)	(107,686)
未分配一般及行政費用	(57,920)	(50,386)	(60,769)
未分配其他收益(虧損)	688	(5,187)	(2,605)
重組費用	(304,316)	(755)	(7,455)
其他支出	(27,938)	(14,418)	(9,231)
除稅前(虧損)盈利	(222,025)	106,568	35,276
分部盈利率			
半導體解決方案			
– 一次性存貨註銷前	4.4%	8.7%	7.9%
– 一次性存貨註銷後	0.5%	8.7%	7.9%
表面貼裝技術解決方案	9.1%	3.8%	6.3%

3. 銷貨成本

集團於二零二五年第三季度確認一次性存貨註銷，共港幣 7,390 萬元。此次註銷源於產品簡化計劃，主要因為集團對半導體解決方案分部的一間附屬公司先進半導體設備（深圳）有限公司進行自願性清盤。此舉旨在優化集團的產品組合。

4. 每股(虧損)盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄(虧損)盈利之 本公司持有人應佔之本期間(虧損) 盈利	(269,877)	131,214	25,908
	股份數量 (以千位計)		
	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二五年 六月三十日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本(虧損)盈利之普通股加 權平均股數	416,202	416,306	414,167
潛在攤薄影響之股數：			
– 僱員股份獎勵計劃	1,268	512	1,596
計算每股攤薄(虧損)盈利之普通股加 權平均股數	417,470	416,818	415,763

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬

就財務表現回顧，集團已提供經調整盈利及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告會計準則呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括 i) 主要與僱員遣散費用及福利安排和停工相關成本的重組成本，及 ii) 主要源於為優化產品組合，於二零二五年第三季度集團對半導體解決方案分部(「SEMI」)的一間附屬公司先進半導體設備(深圳)有限公司進行自願性清盤的一次性存貨註銷。

採用該等非香港財務報告會計準則計量作為分析及比較工具存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告會計準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，該等非香港財務報告會計準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告會計準則編製的二零二五年第三季度、二零二五年第二季度及二零二四年第三季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

截至二零二五年九月三十日止三個月 非香港財務報告會計準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	一次性 存貨註銷 港幣千元 (未經審核)	重組成本 港幣千元 (未經審核)	相關 所得稅 之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
毛利	1,305,750	73,884	—	—	1,379,634
毛利率	35.7%				37.7%
經營利潤	50,480	73,884	—	—	124,364
期間(虧損)盈利	(268,599)	73,884	304,316	(7,693)	101,908
盈利率	-7.3%				2.8%
本公司持有人應佔(虧損) 盈利	(269,877)	73,884	304,316	(7,693)	100,630
每股基本(虧損)盈利	港幣(0.65)元				港幣 0.24 元

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬(續)

截至二零二五年六月三十日止三個月
非香港財務報告會計準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組成本 港幣千元 (未經審核)	所得稅 之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
期間盈利	134,338	755	(210)	134,883
盈利率	3.9%			4.0%
本公司持有人應佔盈利	131,214	755	(210)	131,759
每股基本盈利	港幣 0.32 元			港幣 0.32 元

截至二零二四年九月三十日止三個月
非香港財務報告會計準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組成本 港幣千元 (未經審核)	所得稅 之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
期間盈利	23,845	7,455	(1,776)	29,524
盈利率	0.7%			0.9%
本公司持有人應佔盈利	25,908	7,455	(1,776)	31,587
每股基本盈利	港幣 0.06 元			港幣 0.08 元

下表載列集團半導體解決方案分部根據香港財務報告會計準則編製的二零二五年第三季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

截至二零二五年九月三十日止三個月
非香港財務報告會計準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	一次性 存貨註銷 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
<u>半導體解決方案分部</u>			
毛利	701,959	73,884	775,843
毛利率	37.3%		41.3%
分部盈利	8,735	73,884	82,619
分部盈利率	0.5%		4.4%

半導體解決方案分部於二零二五年第二季度和二零二四年第三季度皆無相應的非香港財務報告會計準則計量調整。

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二五年九月三十日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二五年十月二十八日

(本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。)